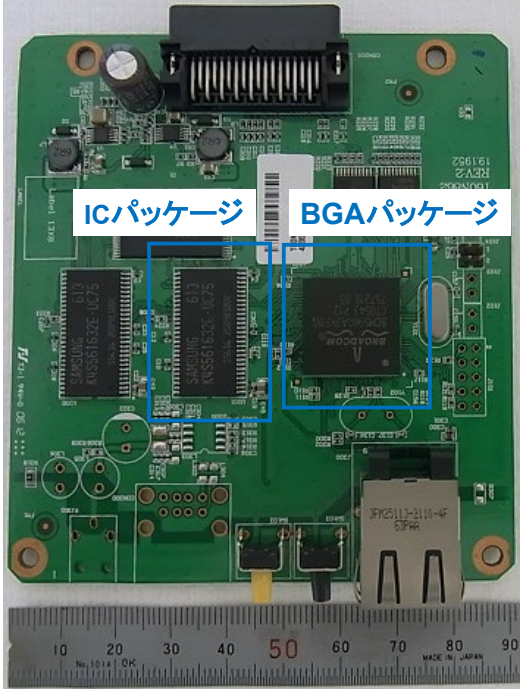
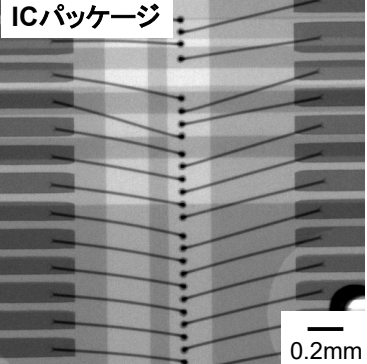
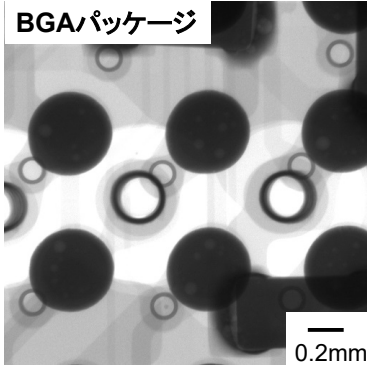



×線を用いた非破壊内部微細構造観察

事例	<p>×線を用いて実装 IC パッケージの内部構造の透視観察を行いました。</p>
試験内容 と結果	<p>マイクロフォーカスX線透視装置を用いて、プリント基板に実装されたICパッケージの内部の微細構造を観察しました。</p> <p>実装ICパッケージの内部にあるボンディングワイヤーやBGA(Ball Grid Array)の bumps を観察することができます。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="376 533 783 584" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">プリント基板の外観</div> <div data-bbox="940 533 1477 584" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">青色で囲んだ IC パッケージ内部の透視画像</div> </div>   
使用装置	<p>マイクロフォーカス×線透視装置（令和2年度電源立地地域対策交付金）</p>  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>メーカー名： 株式会社島津製作所 型式： SMX-1000L Plus</p> <p>【機器の概要】 X線管電圧: 20～90kV (10kVステップ) X線管電流: 0～250 μ A (1 μ Aステップ) 検査可能サイズ: 520mm×620mm 試料重量: 最大5kg 画像分解能: 5 μ m 透視視野: 1.7mm² ～ 35mm² X線検出器傾動: 最大60度</p> </div>
手数料	<p>マイクロフォーカス X 線透視装置試験 6, 200円／時間</p>

※測定物のサイズや形状、材質によってはできない場合があります。